

2025年12月18日

各 位

会 社 名 太洋テクノレックス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 細 江 正 大
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 電 子 部 品 部 長 八 嶋 栄 一
電 話 0 7 3 - 4 3 1 - 6 3 1 1

第40回インターネットコンジャンパンへの出展のお知らせ

当社は、2026年1月21日（水）～23日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第40回インターネットコンジャンパン」に「体感」、「高密度」、「宇宙」をテーマとして出展いたします。

本展示会では、展示している多様なFPC（フレキシブルプリント基板）をご覧いただくだけでなく、直接触れていただくことでFPCの特徴を体感いただきます。また、2025年10月27日付け「パターンビアフィル工法による高密度配線の形成技術向上について」にて公表いたしましたフィルドビア構造を有した高密度配線FPCの展示や、開発中の宇宙産業用FPCに関して、技術優位性と開発状況についてご紹介いたします。中でも、極めて高い信頼性が求められる宇宙産業用FPCにつきましても、極端な温度変化、激しい振動、真空中でのガス放出（アウトガス）、放射線等、FPCにとって最も過酷な環境条件下での使用が想定されることから、JAXA等の規格要求を視野に入れた開発を進めており、実際に過酷な環境下での耐熱性・耐振動性を実現するための特殊材料の選定と構造設計を施した試作品を展示いたします。

当社が追求するFPC技術の進化とその可能性をぜひ当社ブースにてお確かめください。

以 上